

2013-2018年中国印制电路板（PCB）行业深度调研及未来发展方向研究报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2013-2018年中国印制电路板（PCB）行业深度调研及未来发展方向研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201308/215985.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

在中国成为电子产品制造大国的同时，全球PCB产能也在向中国转移，不仅内资PCB制造企业加速扩大产能，外资企业也同时加速向中国转移、新增产能，国内PCB行业投资始终火热。产业转移成就中国PCB产业大国，最重要的动力来源于成本和应用产业链两方面。在成本优势方面，中国在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面具有巨大的优势；下游产业在中国的蓬勃发展，全球整机制造转移中国，提供了巨大的市场需求空间。中国由于下游产业的集中及劳动力、土地成本相对较低，成为发展势头最为强劲的区域。

印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，简称印制板，英文简称PCB(printed circuit board)或PWB(printed wiring board)，以绝缘板为基材，切成一定尺寸，其上至少附有一个导电图形，并布有孔（如元件孔、紧固孔、金属化孔等），用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。习惯称“印制线路板”为“印制电路”是不确切的，因为在印制板上并没有“印制元件”而仅有布线。

《2013-2018年中国印制电路板（PCB）行业深度调研及未来发展方向研究报告》根据对印制电路板（PCB）产品监测统计数据指标体系，通过技术手段，形成的连续性监测数据，反映了一定时期内中国印制电路板（PCB）产品生产消费的现状、变化及趋势。本报告以印制电路板（PCB）行业作为切入点，通过对印制电路板（PCB）行业特征和统计数据的全面分析，确定印制电路板（PCB）行业发展概况和基本特征；运用科学的方法和模型，帮助企业掌握市场动向，明确印制电路板（PCB）行业竞争趋势。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

第一章 印制电路板（PCB）的相关概述

第一节 PCB的介绍

一、PCB的定义

二、PCB的分类

三、PCB的历史

第二节 PCB的产业链

一、PCB产业链的构成

二、产业链中的产品介绍

第二章 国际PCB产业发展分析

第一节 全球PCB产业发展概况

一、国际重点PCB制造企业发展概述

二、2012年全球PCB工业发展分析

三、2013年全球PCB行业发展分析

四、2013年全球PCB产业的格局变化

五、2013年国际柔性电路板行业的发展

六、国外印制电路板制造技术的发展

七、2013年全球PCB行业发展分析及预测

第二节 美国

一、美国PCB产业的发展概况

二、美国PCB主要生产厂家的发展

三、2013年北美印刷电路板发展现状

第三节 欧洲

一、欧洲PCB产业发展概况

二、2013年德国PCB产业的发展

三、2013年欧洲PCB行业发展分析

第四节 日本

一、日本PCB产业的发展阶段

二、日本PCB产业的发展回顾

三、2013年日本PCB产业的发展

四、日本领先PCB厂商发展高端路线

第五节 台湾地区

一、2012年台湾PCB产业的发展

二、2013年台湾PCB产业的发展

三、台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

第三章 中国PCB产业发展分析

第一节 我国PCB产业的发展概况

一、我国PCB产业的产值及产能

二、我国PCB产业的产品结构

三、我国PCB行业配套日渐完善

四、2013年我国PCB行业的发展

五、2013年我国PCB产业的发展机遇

第二节 PCB产业竞争力分析

一、竞争对手

二、替代品

三、潜在进入者

四、供应商的力量

第三节 HDI市场发展分析

一、HDI市场容量

二、HDI市场供求

三、HDI市场趋势

第四节 我国PCB产业发展问题及对策

一、我国PCB产业与国外存在的差距

二、PCB产业发展面临的挑战

三、PCB产业持续发展的措施

四、PCB产业需发展民族品牌

第四章 PCB制造技术的研究

第一节 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

一、PCB芯片封装的介绍

二、PCB芯片封装的主要焊接方法

三、PCB芯片封装的流程

第二节 光电PCB技术

一、光电PCB的概述

二、光电PCB的光互连结构原理

三、光学PCB的优点

四、光电PCB的发展阶段

第三节 PCB技术的发展趋势

一、向高密度互连技术方向发展

二、组件埋嵌技术的发展

三、材料开发的提升

四、光电PCB的前景广阔

五、先进设备的引入

第五章 PCB上游原材料市场分析

第一节 铜箔

一、铜箔的相关概述

二、铜箔在柔性印制电路中的应用

三、电解铜箔产业的发展概况

第二节 环氧树脂

一、环氧树脂的相关概述

二、环氧树脂的主要应用领域

三、我国环氧树脂产业的发展现状

第三节 玻璃纤维

一、玻璃纤维的相关概述

二、我国成为全球最大玻璃纤维生产国

三、2013年我国玻璃纤维行业经济运行情况

四、2013年玻璃纤维产业的发展情况

第六章 PCB下游应用领域分析

第一节 消费类电子产品

- 一、2013年我国消费电子产品走向高端
- 二、消费电子用PCB市场需求稳定增长
- 三、高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

第二节 通讯设备

- 一、2013年我国通讯设备制造业发展情况
- 二、2013年我国通信设备业的发展
- 三、语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

第三节 汽车电子

- 一、PCB成为汽车电子市场的热点
- 二、多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大
- 三、2013年全球汽车电子PCB市场发展预测

第四节 LED照明

- 一、2013年中国LED照明的发展状况
- 二、LED发展为PCB行业带来新需求

第七章 国外重点PCB制造商介绍

第一节 日本企业

- 一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)
- 二、日本旗胜 (Nippon Mektron)
- 三、日本CMK公司

第二节 美国企业

- 一、MULTEK
- 二、美国TTM
- 三、新美亚 (SANMINA-SCI)
- 四、惠亚集团 (Viasystems)

第三节 韩国企业

- 一、三星电机 (Samsung E-M)
- 二、永丰 (Young Poong Group)
- 三、LG Electronics

第四节 台湾企业

- 一、欣兴电子
- 二、健鼎科技
- 三、雅新电子

第八章 国内PCB上市公司介绍

第一节 沪电股份

- 一、公司简介
- 二、2012年沪电股份经营状况分析
- 三、2013年沪电股份经营状况分析

第二节 天津普林

- 一、公司简介
- 二、2012年天津普林经营状况分析
- 三、2013年天津普林经营状况分析

第三节 生益科技

- 一、公司简介
- 二、2012年生益科技经营状况分析
- 三、2013年生益科技经营状况分析

第四节 超声电子

- 一、公司简介
- 二、2012年超声电子经营状况分析
- 三、2013年超声电子经营状况分析

第五节 超华科技

- 一、公司简介
- 二、2012年超华科技经营状况分析
- 三、2013年超华科技经营状况分析

第六节 上市公司财务比较分析

- 一、盈利能力分析
- 二、成长能力分析
- 三、营运能力分析
- 四、偿债能力分析

第九章 2013-2017年PCB行业投资分析及前景预测

第一节 2013-2017年PCB投资分析

- 一、PCB行业SWOT分析
- 二、PCB投资面临的风险
- 三、PCB市场投资空间大

第二节 2013-2017年PCB产业发展前景预测

- 一、2013年PCB产业的发展前景
- 二、2013年软板与HDI板发展前景向好
- 三、2013-2017年我国印制电路板产业的发展前景预测

四、未来我国PCB行业将保持高速增长

五、十二五期间我国PCB产业的发展重点

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201308/215985.html>